



## ウエハプロセスエンジニア

装置導入ご経験をお持ちの方募集！

### 募集職種

#### 採用企業名

日本ルメンタム株式会社

#### 求人ID

1585701

#### 業種

電気・電子・半導体

#### 会社の種類

中小企業 (従業員300名以下)

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

神奈川県, 相模原市中央区

#### 給与

750万円 ~ 1300万円

#### 勤務時間

9:00~17:30 (休憩45分)

#### 休日・休暇

完全週休二日制

#### 更新日

2026年04月15日 00:00

### 応募必要条件

#### 職務経験

3年以上

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

基礎会話レベル (英語使用比率: 25%程度)

#### 日本語レベル

ネイティブ

#### 最終学歴

大学卒: 学士号

#### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

### 募集要項

#### ◀募集要項・本ポジションの魅力▶

- 光通信用半導体レーザ・フォトダイオードのウエハプロセス開発・改善をリード
- 世界のデータセンタやAI通信インフラ性能向上に直結する業務でやりがいを実感
- 導入装置の立上げや量産移行に関わり、プロセス改善を即実装できる自由度の高い環境
- 年間休日125日、社保・財形・住宅手当など福利厚生が充実

### 【業務内容】

AI・HPC・次世代通信を支える「電子I/Oの限界を超える光I/O」。

日本ルメンタムは、この構造転換の中核となる光半導体デバイスを自社開発・量産化する拠点です。

本ポジションは、光通信用半導体レーザー・フォトダイオードのウエハプロセス領域をリードし、産業変革を支えるキーデバイスを共に創るエンジニアを求めています。

### <具体的な仕事内容>

エピタキシャル以外の化合物半導体ウエハプロセス領域（フォトリソ、エッチング等）において、高信頼・高歩留りな光デバイス製造を実現するプロセス開発・改善を主導します。

- ・ 光デバイスウエハプロセスの工程改善・歩留向上・生産不具合解析
- ・ 新規ウエハプロセス技術の探索・設計・量産立上げ
- ・ 露光装置（縮小投影露光機）や電子線描画装置を用いた微細加工工程の最適化
- ・ 新規導入装置の技術選定・評価・立上げ・量産移行支援
- ・ 他プロセスエンジニア／設計／製造／品質部門との横断的な課題解決推進デバイス開発／製造におけるエピタキシャル以外のウエハプロセス工程業務

### ■ミッション・価値：

本職務は、AI/HPC時代に求められるTbps級データ処理を光で実現する中核技術を担います。

微細加工・材料制御・工程安定化の一つひとつが、世界中のデータセンタやAIチップ間通信の性能に直結する社会的意義を持ちます。

“プロセス改善＝産業の通信インフラ性能を引き上げる”という、極めてダイレクトな価値創出を体感できるポジションです。

### ■キャリアプラン：

本領域は、今後5年で世界的に\*\*人材希少性が急上昇する「光I/Oウエハプロセス技術」\*\*です。

電子から光への転換が本格化する中、光デバイスプロセスの理解と改善実績を持つ技術者は、グローバル市場で競争力の高いキャリアを築くことができます。

日本ルメンタムでは、設計～量産の距離が極めて近い環境下で、自らの提案を即実装できる意思決定スピードを経験できる点も大きな魅力です。

### ■当社について：

当社は、データセンタ/AIクラスタ/次世代ワイヤレス通信（6G）に不可欠な光送受信トランシーバ向けのDML（Directly Modulated Laser）、EML（Electro-absorption Modulator Integrated with DFB Laser）を主力製品とし、CWDM/L-WDMなど多波長帯の高速光デバイスを展開。

電子伝送の限界に直面する産業構造の中で、光I/Oへの転換を先導するポジションを確立しています。

### 【雇用形態】

正社員

### 【給与】

年収：750万円～1300万円（非管理職は残業30H含む、超過分は別途支給 / 管理職は残業代は支給なし）

■業績連動インセンティブあり（年1回）

■定年60歳、給与変更なし、昇給昇格あり、1年更新

### 【就業時間】

9:00～17:30（休憩45分）

### 【勤務地】

〒252-5250 神奈川県相模原市中央区小山4-1-5 5

■受動喫煙対策：屋内喫煙室あり

### 【休日休暇】

- ・ 年間休日125日
- ・ 完全週休二日制

### 【待遇・福利厚生】

- ・ 社保完備
- ・ 財形貯蓄
- ・ カフェテリアプラン等
- ・ 住宅手当（対象：単身30歳を迎える誕生日まで。または単身赴任者・最大25,000円）
- ・ 既婚者住宅手当（対象：借り主である物件。40歳を迎える誕生日まで・最大40,000円）

## スキル・資格

### 【必須要件】

- ・ 半導体光デバイス（レーザー/PD等）の開発または製造工程における実務経験5年以上
- ・ 化合物半導体ウエハプロセス（エッチング/リソグラフィ/金属膜形成/パッシベーション/蒸着等）経験
- ・ ウエハプロセス装置の立ち上げ経験
- ・ 工程改善活動（歩留向上・不良解析・統計的工程管理等）の経験
- ・ 半導体光デバイス（レーザー/PD等）の開発または製造工程における実務経験5年以上
- ・ 化合物半導体ウエハプロセス（エッチング/リソグラフィ/金属膜形成/パッシベーション等）経験
- ・ 工程改善活動（歩留向上・不良解析・統計的工程管理等）の主導経験
- ・ 英文メール/技術ドキュメント/オンライン会議での英語コミュニケーション能力（TOEIC700相当）

### 【歓迎要件】

- 電子線描画装置／縮小投影露光装置／ICPエッチング装置／CVD装置や研磨装置等の立上げ経験
- 光デバイス特性（波長、光出力、反射耐性、歩留り）とプロセス要因の相関解析スキル
- 英語での技術議論や発表に抵抗のない方（日本語併用可）

【求める人物像】

- 現場課題を自ら抽出し、改善をリードできる能動的エンジニア
- 製造・設計・品質を横断して技術的合意形成を進められる対話力と論理性
- 生産ラインを拡張している中で、装置立ち上げ、自動化、データ活用にお強みがある方
- 「電子では届かない速度領域を、光で切り拓く」というミッションに共感できる方

---

会社説明